



東京エレクトロン デバイス株式会社

[第2四半期] 第 **32** 期
中間報告書
平成28年4月1日 → 平成28年9月30日

証券コード 2760



株主の皆様へ

株主の皆様には、平素から格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社第32期中間報告書（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）として事業の概況等をご報告いたします。

代表取締役社長 徳重 敦之

当中間期（第2四半期）の経営成績

当中間期におけるわが国経済は、生産動向に持ち直しの兆しがあるものの、個人消費や輸出に力強さが欠ける状況で推移しております。円高や海外経済の弱さなどの影響により、景気の先行きに対する不透明感が拭えない状況となっております。

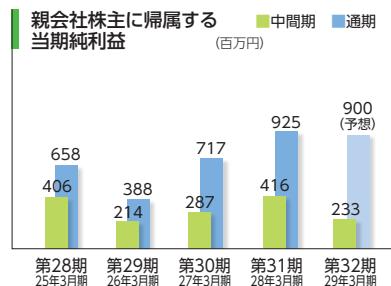
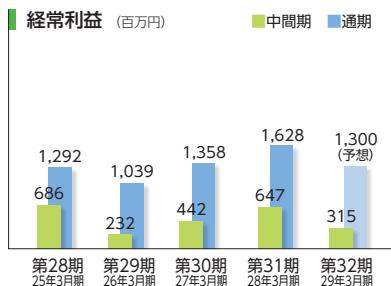
当社グループにおける当中間期の連結業績については、売上高602億4千1百万円（前年同期比5.4%増）、半導体及び電子デバイス事業における売上構成の変化や急激な為替変動等で売上総利益が減少したことにより営業損失1億2千8百万円（前年同期は営業利益7億8千8百万円）、一方で、為替差益を計上したことなどにより経常利益3億1千5百万円（前年同期比51.2%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益2億3千3百万円（前年同期比44.0%減）となりました。

業績予想の修正

平成29年3月期の通期連結業績予想については、当中間期（第2四半期）までの売上推移を踏まえつつ、第3四半期以降におけるビジネス動向を勘案し、また、期首に設定した想定為替レート（1USドル=109円）を1USドル=100円に見直した結果、次のとおり修正することといたしました。

	売上高	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回（平成28年4月26日）発表予想（A）	123,000	1,700	1,130	112.76
今回発表予想（B）	125,200	1,300	900	89.81
増減額（B-A）	2,200	△400	△230	—
増減率（%）	1.8	△23.5	△20.4	—
（参考）前期連結実績（平成28年3月期）	117,831	1,628	925	92.55

連結業績ハイライト



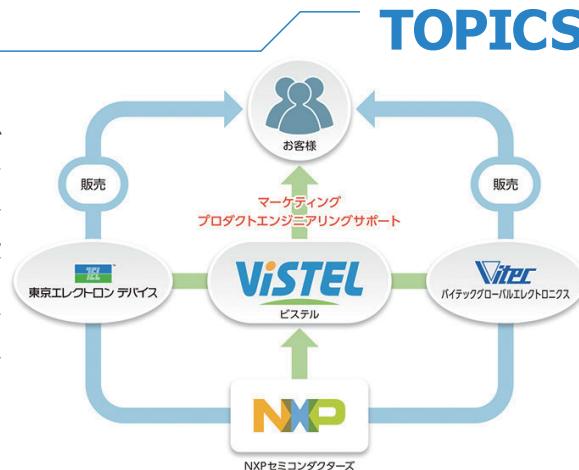
TOPICS

ビステル株式会社 設立

当社と株式会社バイテックホールディングスのグループ会社「バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社」は、NXPセミコンダクターズ（以下NXP）製品に関する販売マーケティング及びプロダクトエンジニアリングサポートを主な事業内容とする合併会社「ビステル株式会社」を9月1日に設立いたしました。

ビステル株式会社は、NXP製品の販売・エンジニアリングサポートにおいて両社の得意分野を結集することで相乗効果を生み出し、これまでも増して高い付加価値を提案し、お客様のご期待にお応えいたします。

※平成28年10月より営業開始



株式会社アバールデータと業務資本提携

当社と株式会社アバールデータ（以下アバールデータ）は、両社の得意分野の要素技術を持ち寄ることで部品選定から設計・製造・販売までより迅速に行えるようになり、新たな市場及び成長事業の開拓が期待できるものと判断し、8月30日に業務提携を決定いたしました。また、両社が業務提携について検討を進めるなか、業務提携の成果を一層増大させるため、両社が同等金額の株式を持ち合う形による資本提携を実施いたしました。

＜業務提携の内容＞

- ①ASICやLSIを用いたモジュール化の企画・設計・製造
- ②それぞれのブランド製品の設計・製造における相互協力
- ③アバールデータ製品の販売

＜資本提携の内容＞

- ①当社によるアバールデータ株式の取得
アバールデータ株式35,000株(総額30,450千円)を取得。
- ②アバールデータによる当社株式の取得
当社株式20,000株(総額30,522千円)を取得。

株主還元について

当社は株主重視を経営の最重要事項の一つと位置付けており、株主の皆様に対する利益還元と経営基盤を強化するための内部留保とのバランスを考慮しつつ、株主還元の充実を図ることを基本方針といたします。

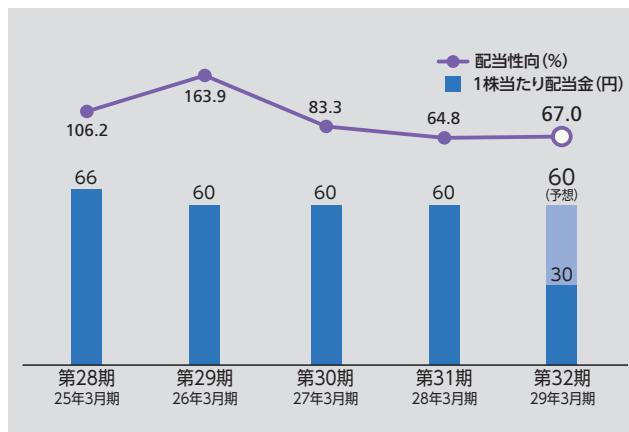
継続的かつ安定的な配当実施に加え、業績を反映した利益還元の視点に基づく配当政策として、配当性向の目安は親会社株主に帰属する当期純利益の50%以上、かつ、資本効率を示すROEと連動するDOE（株主資本配当率）*は2.5%を下限としてまいります。

また、自己株式の取得については、資本政策や経営環境の変化を勘案し、機動的・弾力的に実施してまいります。

当中間期の1株当たり配当金は30円とさせていただきます。期末の1株当たり配当金は30円、通期で60円を予定しております。

※DOE（株主資本配当率）

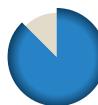
株主資本に対し、どの程度の配当が利益還元として実施されているのかを示す指標であり、「配当性向×ROE」という算定式によって導き出されます。



*1株当たり配当金は平成25年10月1日の株式分割（1株→100株）を反映した金額にて記載しております。

半導体及び電子デバイス事業

売上高構成比
87.7%



売上高 52,852百万円

半導体の需要は総じて堅調に推移いたしました。特に、スマートフォンの高機能化やデータセンター向けなどの需要が旺盛であり、加えて、自動車1台当たりの半導体搭載量も増加しております。

このような状況のもと、当社におきましてはストレージや車載向けに半導体の販売が堅調に推移したことに加え、POS向けのソフトウェア販売等が好調に推移した結果、当中間期における売上高は528億5千2百万円(前年同期比8.5%増)となりました。一方、売上構成の変化等によりセグメント利益(経常利益)は1億2千6百万円(前年同期比66.2%減)となりました。



①専用IC

特定用途向けに作られるIC



主な商品と仕入先

DLP用(テキサス・インスツルメンツ社)
通信用(アナログ・デバイス社、ブロードコム社)

主な最終製品

液晶プロジェクト、ストレージ、スマートフォン、FA機器、医療機器

②汎用IC

色々な用途に使用されるIC



主な商品と仕入先

アナログIC(テキサス・インスツルメンツ社、リニアテクノロジー社)

主な最終製品

カーナビゲーション、FA機器、医療機器、OA機器、デジタル家電

③プロセッサ

コンピュータの頭脳として演算・制御機能を持つIC



主な商品と仕入先

マイクロプロセッサ(NXPセミコンダクターズ社、インテル社)
DSP(テキサス・インスツルメンツ社)

主な最終製品

携帯電話基地局、OA機器、医療機器、カーナビゲーション

コンピュータシステム関連事業

売上高構成比
12.3%



売上高 7,389百万円

データ量の増大に対応するため、効率的なネットワーク運用技術等に注目が集まっているものの、前年同期は好調であった銀行や官公庁向けの大型IT投資が、当中間期は軟調に推移いたしました。

このような状況のもと、当社におきましては前年同期の官公庁向け機器販売の反動減等により当中間期における売上高は73億8千9百万円(前年同期比12.5%減)、セグメント利益(経常利益)は1億8千8百万円(前年同期比30.6%減)となりました。

品目別売上高構成比



inrevium

自社ブランド商品のご紹介

3次元形状測定器 『OPTED』

- 平成28年6月販売開始
- 光コム社と共同開発



高速プロジェクタ 『DynaFlash』

- 平成28年10月販売開始
- 東京大学と共同研究



**製造業やインフラ点検の分野で
検査効率向上に貢献**

④光学部品

電気を光に変換して
使用する電子部品



主な商品と仕入先

LED、フォトカプラ (ブロードコム社)

主な最終製品

スマートフォン、車載機器、FA機器

⑤カスタムIC

お客様の仕様に
応じて作られるIC



主な商品と仕入先

ASIC (株)ソシオネクスト
PLD (ラティスセミコンダクター社)
デザインサービス (インレビウム) **inrevium**

主な最終製品

医療機器、FA機器、通信機器、OA機器、
カーナビゲーション

⑥メモリIC

記憶用IC



主な商品と仕入先

FRAM、フラッシュメモリ (サイプレス セミコンダクタ社)

主な最終製品

FA機器、OA機器、通信機器

①ネットワーク関連機器

インターネットの接続負荷の分散、
セキュリティ強化



主な仕入先

F5ネットワークス社
インフォブロックス社

②ストレージ関連機器

大容量データの記憶、
統合技術によるコスト削減

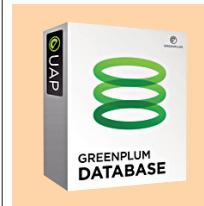


主な仕入先

プロレード
コミュニケーションズ
システムズ社
EMC社
ビューアストレージ社

③ソフトウェア他

データ管理を行うデータベース



主な仕入先

日本オラクル社
ピボタル
ソフトウェア社

連結財務諸表

中間(第2四半期) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	前 期	当中間期
	(平成28年3月31日現在)	(平成28年9月30日現在)
流動資産	59,340	59,494
固定資産	4,944	4,826
資産合計 POINT1	64,284	64,321
流動負債	28,189	28,458
固定負債	13,921	13,954
負債合計 POINT2	42,110	42,413
純資産合計 POINT3	22,174	21,908
負債及び純資産合計	64,284	64,321

POINT1 資産合計

総資産は643億2千1百万円となり、前期末に比べ3千6百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が減少した一方、受取手形及び売掛金が増加したことによりです。

中間(第2四半期) 連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	前中間期	当中間期
	(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)	(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)
売上高	57,143	60,241
売上原価	49,537	53,855
売上総利益	7,605	6,386
販売費及び一般管理費	6,816	6,515
営業利益又は営業損失(△)	788	△ 128
経常利益	647	315
特別利益	8	0
特別損失	14	3
法人税等	224	79
親会社株主に帰属する当期純利益	416	233

POINT2 負債合計

負債総額は424億1千3百万円となり、前期末に比べ3億2百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金が増加したことによりです。

POINT3 純資産合計

純資産は219億8百万円となり、前期末に比べ2億6千5百万円の減少となりました。

以上の結果、自己資本比率は34.1%となり、前期末に比べ0.4ポイント低下いたしました。

中間(第2四半期) 連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円)

科 目	前中間期	当中間期
	(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)	(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,421	△ 540
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 42	△ 198
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,339	242
現金及び現金同等物の期首残高	2,302	2,637
現金及び現金同等物の期末残高	1,342	2,103

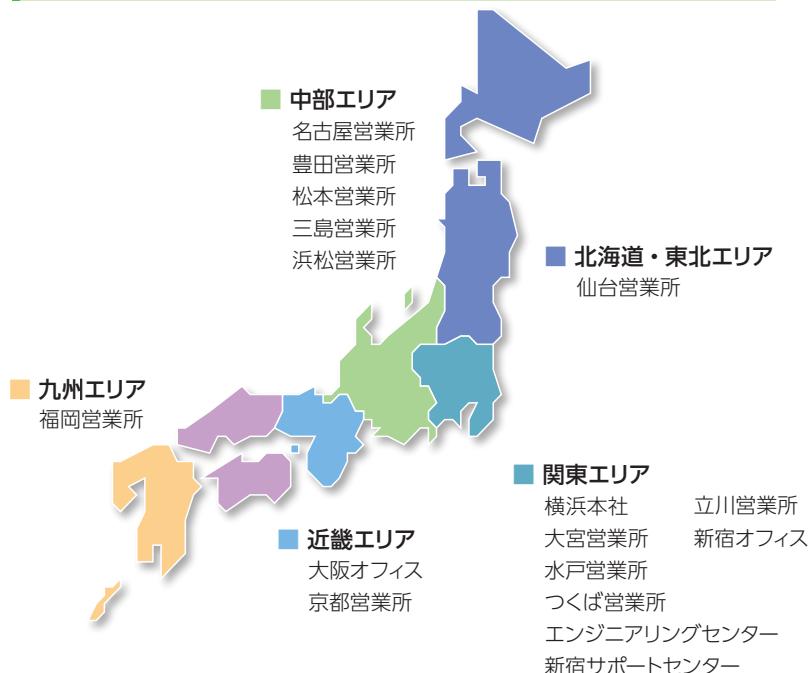
(注) 連結財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

会社の概要 (平成28年9月30日現在)

会社概要

商号	東京エレクトロン デバイス株式会社 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED
設立	昭和61年3月3日
資本金	2,495,750,000円
従業員数	959名(連結)
本拠地	神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア パネトロン株式会社
子会社	東電電子零件亞太區有限公司 (TED APAC) 上海華桑電子零件貿易有限公司 (TED上海) TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. (TEDシンガポール) TOKYO ELECTRON DEVICE (THAILAND) LIMITED (TEDタイ) inrevium AMERICA, INC. (インレビウムアメリカ) TOKYO ELECTRON DEVICE CN AMERICA, INC. (TED CNアメリカ)
関連会社	ビステル株式会社(平成28年10月営業開始) Fidus Systems Inc. 上海新致華桑電子有限公司 無錫新致華桑電子有限公司

主な拠点 (国内)



役員等

取締役

取締役会長	久我 宣之
代表取締役社長	徳重 敦之
代表取締役	長谷川 雅巳
取締役	上小川 昭浩
取締役	佐伯 幸雄
取締役	初見 泰男
取締役	天野 勝之
取締役(非常勤)	常石 哲男
社外取締役	石川 國雄
社外取締役	不破 久温

監査役

常勤監査役	中村 隆
常勤監査役	河合 信郎
社外監査役	福森 久美
社外監査役	成瀬 圭珠子

執行役員

社長	徳重 敦之
執行役員常務	長谷川 雅巳
執行役員常務	上小川 昭浩
執行役員常務	佐伯 幸雄
執行役員	初見 泰男
執行役員	浅野 升徳
執行役員	上善 良直
執行役員	安村 達志
執行役員	篠田 一樹
執行役員	岩田 郁雄
執行役員	土肥 健史

株式情報 (平成28年9月30日現在)

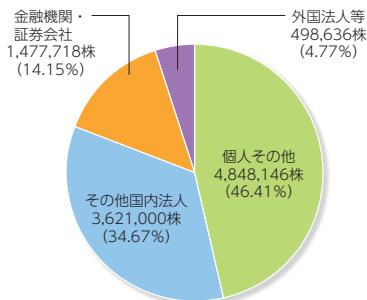
株式の状況

- 発行可能株式総数 25,600,000株
- 発行済株式総数 10,445,500株
- 株主数 7,348名
- 大株主

株主名	持株数	出資比率
	株	%
東京エレクトロン株式会社	3,532,700	33.82
東京エレクトロンデバイス社員持株会	420,353	4.02
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	410,100	3.93
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口・75722口)	240,300	2.30
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	160,900	1.54

株式分布状況

●所有者別株式数



※自己株式35株は、「個人その他」に含めております。



半導体及び電子デバイス事業にて認証取得

この報告書は、森林認証を受けたFSC®認証紙および、低VOCの植物油インキを使用しています。

株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月
基準日 定時株主総会については、毎年3月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
配当支払株主確定日 期末配当 毎年3月31日
中間配当 毎年9月30日
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
(郵便物送付先) 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
(電話照会先) 三井住友信託銀行株式会社証券代行部
0120-782-031 (フリーダイヤル)
同取次所 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店
公告の方法 電子公告
上場金融商品取引所 東京証券取引所 市場第一部
(証券コード 2760)

●「配当金計算書」について

配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。確定申告をされる株主様は大切に保管ください。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いいたします。

コーポレートメッセージ



「Connect Beyond」は、ステークホルダーの皆さまの期待と信頼に応えるため、あらゆる既存概念を超えて、皆さまと共に新たな価値の創造に挑戦するという私たちの姿勢を表しています。

